

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁶
A01M 13/00

(11) 공개번호 특 1995-0002582
(43) 공개일자 1995년 02월 16일

(21) 출원번호	특 1994-0018505
(22) 출원일자	1994년 07월 28일
(30) 우선권주장	93-187965 1993년 07월 29일 일본(JP) 94-063027 1994년 03월 31일 일본(JP)
(71) 출원인	스미토모 가가꾸 고오교 가부시끼가이샤 고사이 아끼오
(72) 발명자	일본국 오오사카시 주오구 기따하마 4쵸메 5방 33고 우에다 미노루 일본국 오오사카후 도요나카시 우에노니시 2-13-33 오까다 겐야 일본국 효고켄 다카라즈카시 메후 2-14-7
(74) 대리인	이준구, 박해선

심사청구 : 없음

(54) 약제의 가열 증발 테이프 및 약제의 가열 증발법

요약

약제를 실질적으로 함유하지 않는 기재층의 한 면에 약제를 함유하는 도료를 적용하여 형성된 약제를 함유하는 도막층 및 약제를 실질적으로 함유하지 않는 기재층에 관한 것이다. 또한 본 발명은 테이프를 발열체 상에 테이프 기재층의 비도포층을 발열체와 접촉케 하면서 이동시킴을 특징으로 하는 가열 증발 방법에 관한 것이다.

대표도

도 1

명세서

[발명의 명칭]

약제의 가열 증발 테이프 및 약제의 가열 증발법

[도면의 간단한 설명]

제 1 도는 본 발명의 가열 증발법에 사용되는 장치를 나타내는 사시도이다, 제 2 도는 사용되는 제 1 도의 장치를 나타내는 사시도이다, 제 3 도는 본 발명의 가열 증발법에 사용되는 다른 장치를 나타내는 사시도이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

약제를 실질적으로 함유하지 않는 기재층의 한 면에, 약제를 함유하는 도료를 적용하여 형성된 가열증발 가능한 약제를 함유하는 도막층 및 약제를 실질적으로 함유하지 않는 기재층을 함유하는 테이프.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 도료는 유성 페인트, 섬유성 도료, 합성 수지 에나멜 및 와니스, 및 플루오로폴리머 수지 에나멜 및 오니스로부터 선택되고; 가열 증발 가능한 약제는 가열가능한 살충제, 살균제, 살곰팡이제 및 방향제로부터 선택되며; 기재층은 유리섬유로 강화될 수도 있는 합성수지, 알루미늄 호일 또는 알루미늄 적층 필름으로 만들어진 테이프.

청구항 3

제 2 항에 있어서, 유성 페인트는 보일유, 유성 와니스 또는 정와니스로부터 선택되고; 섬유성 도료는 셀룰로스에 에나멜, 와니스 또는 수지로부터 선택되고; 합성수지 에나멜 및 와니스는 페놀계 수지 에나

벨 및 와니스, 알키드 수지 에나멜 및 와니스, 비닐 수지 에나멜 및 와니스, 에폭시 수지 에나멜 및 와니스, 아크릴산 수지 에나멜, 불포화 폴리에스테르 수지 에나멜 및 와니스, 폴리우레탄 수지 에나멜 및 와니스, 실리콘 수지 에나멜 및 와니스로부터 선택되고 ; 기재층을 만드는데 사용되는 합성 수지는 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리플루오로에틸렌, 폴리아미드 또는 폴리아미드로부터 선택되는 테이프.

청구항 4

제 2 항에 있어서, 도료는 셀룰로스로 수지 에나멜 및 와니스 및 폴리우레탄 수지 에나멜 및 와니스로부터 선택되는 테이프.

청구항 5

제 2 항에 있어서, 약제는 살충제 또는 살곰팡이제인 테이프.

청구항 6

제 2 항에 있어서, 약제는 피레트로이드 화합물, 유기인 화합물, 카르바메이트 화합물 또는 아릴아졸 화합물인 테이프.

청구항 7

제 2 항에 있어서, 약제는 피레트로이드 화합물인 테이프.

청구항 8

제 2 항에 있어서, 약제는 알레트린, 프랄레트린, 푸라메트린, 퍼메트린 또는 벤틀루트린인 테이프.

청구항 9

약제를 실질적으로 함유하지 않는 기재층의 한 면에, 약제를 함유하는 도료를 적용하여 형성된 가열가능한 약제를 함유하는 도막층 및 약제를 실질적으로 함유하지 않는 기재층을 함유하는 테이프를 테이프 기재층의 비도포층을 발열체와 접촉케 하면서 발열체 상에 이동시킴을 특징으로 하는 약제의 가열 증발 방법.

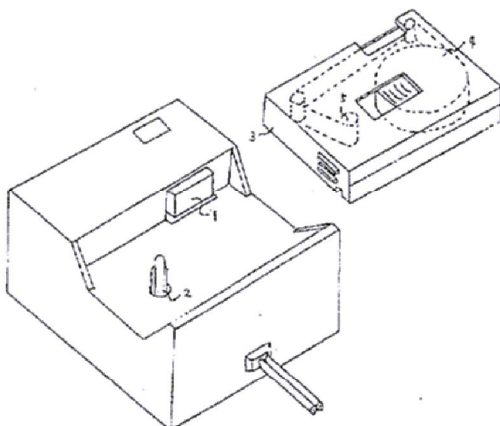
청구항 10

악제를 실질적으로 함유하지 않는 기재층의 한 면에, 살충제, 살균제 또는 살곰팡이제를 함유하는 도료를 적용하여 형성된 살충제, 살균제 또는 살곰팡이제를 함유하는 도막층 및 악제를 실질적으로 함유하지 않는 기재층을 함유하는 테이프를 테이프 기재층의 비도포층을 발열체와 접촉케 하면서 발열체 상에 이동시킴으로써 가열 증발 가능한 살충제, 살균제 또는 살곰팡이제의 증발을 특징으로 하는 해충 방제법.

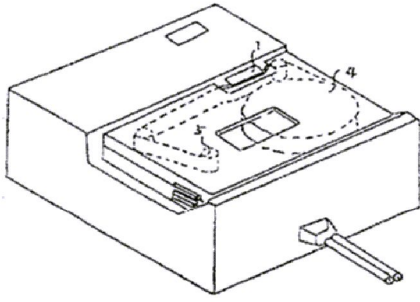
※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1



도면2



도면3

